

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2007年9月7日 (07.09.2007)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2007/099674 A1

- (51) 国際特許分類:  
C08G 59/24 (2006.01) C08G 59/62 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/322474
- (22) 国際出願日: 2006年11月10日 (10.11.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2006-052537 2006年2月28日 (28.02.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大日本インキ化学工業株式会社 (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1748520 東京都板橋区坂下3丁目3番5号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 有田 和郎 (ARITA, Kazuo) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP). 小椋 一郎 (OGURA, Ichirou) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP). 森永邦裕 (MORINAGA, Kunihiro) [JP/JP]; 〒2908585 千葉県市原市八幡海岸通12番地 大日本インキ化学工業株式会社 千葉工場内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION, HARDENING PRODUCT THEREOF, NOVEL EPOXY RESIN, NOVEL PHENOLIC RESIN AND SEMICONDUCTOR SEALING MATERIAL

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物、その硬化物、新規エポキシ樹脂、新規フェノール樹脂、及び半導体封止材料

(57) Abstract: An epoxy resin composition that excels in the flame retardance, heat resistance and hardening easiness of hardening product, being suitable for use as a resin composition for semiconductor devices, circuit board units, etc.; for use therein, a novel epoxy resin and novel phenolic resin; and a semiconductor sealing material. This epoxy resin composition is characterized by containing, as indispensable components, (A) epoxy resin having a structure of naphthalene skeleton bonded via an oxygen atom with another arylene skeleton, wherein the total of aromatic nuclei constituting the above naphthalene skeleton and arylene skeleton per molecule is in the range of 2 to 8, and wherein the aromatic nuclei have a (meta)glycidyoxy group as a substituent and (B) hardening agent.

(57) 要約: 硬化物の難燃性、耐熱性、硬化性に優れ、半導体装置や回路基板装置等の樹脂組成物として好適に用いることが出来るエポキシ樹脂組成物、これに用いる新規エポキシ樹脂、新規フェノール樹脂、及び半導体封止材料を提供する。前記のエポキシ樹脂組成物は、ナフタレン構造が酸素原子を介して他のアリーレン構造と結合した構造を有し、かつ、1分子あたりの前記ナフタレン構造及び前記アリーレン基を構成する芳香核の総数が2~8であって、更に、前記芳香核に(メタ)グリシジルオキシ基を置換基として有するエポキシ樹脂(A)及び硬化剤(B)を必須成分とすることを特徴とする。

WO 2007/099674 A1